

个人简历



基本信息

手机: 17807740410

邮箱: chenweilong01@outlook.com

地址: 深圳坪山

籍贯: 广西

求职岗位: 结构工程师

毕业院校: 桂林航天工业学院 (本科)

专业: 飞行器制造工程

政治面貌: 共青团员



工作内容

- 2024 至今 深圳市亿道数码技术有限公司 结构工程师
- 根据产品功能、ID 的需求、参与产品的方案评估及结构设计, 有多个量产项目的经验;
 - 输出手板加工相关需求资料, 跟进手板加工进度、及时沟通处理手板加工、工艺等问题;
 - 塑胶、五金、硅胶, 独立完成产品的结构设计, 做好开模前期评估, 协助完成产品的可靠性测试。
 - 根据需求规格书, 负责 PCB 板堆叠、零部件选型; 输出板框图, 并与硬件、Layout 工程师沟通布局, 完成 PCBA 板的堆叠设计;
 - 负责对手板样品及模具品的组装, 分析出现的问题点, 并给出解决方案;
 - 负责产品内部结构设计、及各物件 (钣金件、塑胶件) 2D/3D、爆炸图、开模清单、整机组装 BOM 等相关资料的输出

项目经历

项目 1: DH2300 (绿联 NAS 个人私有服务器, 已量产 70K)

- 绿联定制项目, 负责亿道对绿联结构端, 从开模到量产全周期管理; 模具 T0/T1 评审, 试产搭建组装 BOM/临时样限度样承认/辅料配打样/产线问题解决/量产 ECN 管理;

典型问题:

试产按键卡死 (卡死率 20%): 排查锁定按键胶厚超差 0.2mm, 识别问题后 ECN 改模, 卡死率归零

量产接口偏位 (type-c 偏位 0.3mm, 不良率 30%): 要求供应商提供 FAI 报告, 识别出壳料对 PCB 接口处无筋骨限位, 导致安装偏位。解决方案: 结构在 C 口处增加支撑骨位。

项目 2: AFR19 高性能 ATX 台式机公板 (AMD 9955X3D) 客户: 机械革命/ACER/极摩客

- 独立主导机械革命 30L 高性能台式整机研发, 结构堆叠 PCB, 前期验证 Thermal、电源、50 系列显卡适配方案, 确认整机方案通过样品验证后进入小批量试产。
- 根据客户要求对整机可靠性测试 (高低温、震动、盐雾、RF、ESD、EMC 等), 对 Fail 项进行结构优化和模具调整。
- 产线问题点追踪, 产线作业指导 (输出组装要求, 段差间隙标准),

面临困难: 超频工况 MOS 管温度顶到温度墙 (100°), 触发降频, 性能无法释放。

方案: 设计侧出风散热装甲 (铝挤型材+CNC 工艺散热片), MOS 温度压至 90°以下, CPU 性能释放 10%。

成果: 已申请发明专利 (审中), 方案横向复制至 3 款同类型 ATX 主板 (适配 RTX40/50 系显卡), 形成部门内该类型主板散热规范。

项目 3: AKK26 MINI PC (联想瑞天 PVT 阶段)

- 独立主导联想 AKK26 系列整机结构研发, 前期主板堆叠, 壳料结构手板验证; 开模评审输出开模资料, CMF 资料; 驻厂推动模具 T0 修改, T1 确认结构限度样; 已进入试产;

典型问题:

T0 阶段发现接口不居中现象, 驻厂 2 天推动模具改模, 识别到塑胶柱做矮 0.3mm, 责令供应商修模改善。

项目 4: DS2 一体机 (俄罗斯政府标案)

- 项目类型: 属于俄罗斯海外政府标案, 具有军工背景; 需要着重考虑 EMC, ESD 方案; 同时一体机要求对特殊结构快拆设计, 前期评估难度较大;
- 目前项目已经进入结项阶段; 期间出现过 EMC fail 问题, 基于经验评估, 一体机塑胶壳料对辐射屏蔽作用较小, 同时考虑出口海外, 在 DVT 阶段导入屏蔽罩+壳料内腔喷涂金属漆工艺; 经过测试成功满足客户 EMC 要求;

项目 5: IDN150 天波收银机 (收银机, 客户: 天波)

- 项目类型: 由 ARM 架构改 X86 主板, 外壳空间小, 对主板散热设计非常苛刻, 客户要求严格;
- 问题点: 客户不熟悉 X86 系统, 不清楚产品定义, 不熟悉散热设计; 针对该问题, 主动与客户沟通, 根据亿道已有设计方案, 给予设计建议, 并成功满足客户要求, 并实现量产;

自我评价

- 熟练使用 CREO, CATIA 进行结构设计、Abaqus CAE 有限元仿真, EMC\ESD\Thermal 经验, 并且能实现量产落地, 高效率的完成工作
- 具有团队精神, 能和同事, 其他部门积极有效沟通配合, 在项目中有问题能够及时的沟通不延误进度
- 工作认真负责, 有责任心, 吃苦耐劳, 具有良好的执行力, 工作存在的问题可以随时回复